

2006年6月2日

三菱マテリアル株式会社
田中電子工業株式会社

中国における金線事業の事業提携について

三菱マテリアル株式会社(本社:東京都千代田区、社長:井手明彦)と田中電子工業株式会社(本社:東京都千代田区、社長:福井康夫)は、中国における半導体ボンディング用金線事業について事業提携することで基本合意に達しました。

具体的には、三菱マテリアルが金線事業の全額出資子会社であるMMCエレクトロニクス杭州社(中国名:杭州菱慶高新材料有限公司、所在地:浙江省杭州市、董事長:本間久義)の持分の49パーセントを本年10月1日を目処に田中電子工業に譲渡し、同社を両社の合弁事業会社といたします。

近年、金線ユーザーである半導体デバイスメーカー、半導体組立受託メーカーが中国へ生産場所を移管しており、今後、中国市場での金線需要拡大が予想されるとともに、ユーザーから早期の現地生産体制確立が求められております。三菱マテリアルは、2002年(平成14年)に業界に先駆けて中国へ進出し、日系企業として唯一、金線の一貫製造ラインを確立し、更なる稼働率向上を目指してまいりました。一方、田中電子工業では多くのユーザーが中国での更なる生産体制拡充を求めており、その対応を進めてまいりました。

今回、両社が中国における金線の製造・販売体制を共同で構築、拡充することにより、生産コストの削減と、今後大きな成長が期待される中国市場における販売力の強化が図れるものと考えております。

<MMCエレクトロニクス杭州社の概要>

社名 : MMCエレクトロニクス杭州社(中国名:杭州菱慶高新材料有限公司)
所在地 : 中華人民共和国浙江省杭州経済技術開発区内
資本金 : 454万米ドル
出資比率 : 三菱マテリアル株式会社100%
事業内容 : 半導体ボンディング用金線の製造及び販売
社長(董事長): 本間 久義
(三菱マテリアル株式会社 電子材料事業カンパニー プレジデント)

以上

<参考資料>

位置図



